

市场热点: HBM (High Bandwidth Memory)市场趋势及产业链分析

近期, HBM 市场备受关注。2023 年 11 月 13 日, 英伟达 H200 携 HBX3E 首发。据海力士纪要透露, 包括 HBM3 和 3E 在内, 明年的产能已经售罄, 需求仍然旺盛。在市场趋势方面, HBM3 预计将在 2024 年占据主导地位, 而 HBM2e 和其他类型的占比将逐渐下降。HBM3 市场格局中, SK 海力士是唯一量产 HBM3 的公司, 预计市场份额将达到 53%。与此同时, 三星和美光也在积极追赶, 预计明年初将实现量产。此外, 海力士的 HBM 芯片出货量预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。这些数据表明, HBM 市场前景广阔, 具有较高的增长潜力。

在产业链方面, HBM 市场主要由 IP, 游材料、晶粒设计制造、晶片制造、封装与测试等五大环节组成其中, 关注方向应集中在上游环节的设备和上游材料。这些环节的发展将直接影响整个产业链的弹性,

综上所述, HBM 市场正处于快速增长阶段, 未来几年将迎来更多的机遇和挑战。对于投资者而言 HBM 市场的动态和产业链的发展趋势具有重要意义。

HBM 市场持续繁荣, 产业链不断拓展和优化。在设备端, **赛腾股份和亚威股份**是重要的参与企业。赛腾入股海外头部晶圆厂 HBM 产线份通过收购日本 OPTIMA 公司进入半导体量检测设备领域, 其产品已成功进服务于三星、海力士、Sunco、沪硅、新异等核心客户。亚威股份则通过参股苏州芯测和收购韩国 GSI 中, 公司, 涉足存储芯片测试机业务, 并稳定供应给海力士。这些企业在设备端的创新和发展为 HBM 市场的进一步扩大提供了有力的支持。

在上游材料方面, **华海诚科和天承科技**等公司表现出色。华海诚科专注于 LMC(液态环氧树脂塑封)材料天承科技则是 TSV《通过芯片键合实现的立体封装)的研发和生产, 客户验证中的产品有望打破外资垄断。领域的领军企业, 其先进封装电镀液在 HBM 市场中占据重要地位。这些公司在上游材料领域的突破和创新为 HBM 产品的质量和性能提供了可靠的保障此外, **雅克科技、壹石通和联瑞新材**等公司也在 HBM 市场中扮演着重要角色。雅克科技是海力士 H 产品的主要供应商, 壹石通则具备 10w-a 球铝的产能, 预计将在 2023 年逐步投入使用。联瑞新材则配套供应 HBM 封装材料 GMC 所用球硅和 Low a 球铝。这些公司在前驱体材料、10w-a 球硅/铝等关键上游材料的生产和供应方面发挥着重要作用, 为整个产业链的稳定和发展提供了有力支撑。

首款基于鸿蒙的机器人发布

2023 年 1 月 17 日,深开鸿(深圳国资+华为哈勃)与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的 kaihongos 人形机器人这款人形机器人拥有 17 个自由度, 搭载了双摄像头和 STM32、RK3568 双运算系统。Aelos 开源鸿蒙版支持图形编程、C/C++、Js/ArKTS 高级编程语言, 可以满足从 K12 到职高校编程的需求。

金板人形机器人被广泛应用于智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景, 通心培战分物智联教学系统, 为这

些领域提供了更智能、更高效的解决方案。

此外, 一些相关公司也值得关注。**科力尔**是华为伺服系统的供应商, 富佳股份是乐聚机器人的供应商, **大众公用**则微量参股了乐聚机器人。优博讯在 2021 年与深开鸿签署了开源鸿蒙的合作框架协议。这些公司和事件都为机器人研发和应用提供了支持和推动

总体来说, 深开鸿和乐聚机器人推出的首款基于开源鸿蒙的 Kaihongos 人形机器人具有重要的意义和市场价值。随着技术的不断进步和应用场景的拓展形机器人将在更多领域得到广泛应用, 并为社会带来更多的便利和发展机遇。

理想汽车 MEGA 车型热销, 开启盲定 1 小时 42 分钟预定量破万

2023 年 11 月 17 日, 盘后消息, 广州车展上理想汽车首款纯电车型 MEGA 正式发布, 并开启了盲定。在短短的 1 小时 42 分钟后, 预定量便突破了 10,000 台, 这款车型有望成为理想汽车的又一现象级产品。据机构预测, 2024 年 MEGA 平均月销量有望达到 5,000 至 6,000 辆。

理想 MEGA 是一款专为中国大家庭打造的 MPV 车型, 全球第一个搭载理想汽车与宁德时代联合研发的麒麟 5C 电池的量产车。该车型拥有充电 12 分钟即可续航 500 公里的强大功能, 为用户提供了极致的充电体验

理想汽车官方已公布 MEGA 的上市计划, 预计将在 2023 年 12 月正式上市, 2024 年 1 月展车进店正式交付用户

此外些相关公司也值得关注。**博俊科技、上声电子、德赛西威、威迈斯**等公司为理想 MEGA 的生产和供应提供了支持。其中, 博俊科技单车价值量为 1,500 元, 预计 2024 年理想汽车在其业务中将占比 37.5%。声电子单车价值量为 1,000 元, 占比 17.3%。**德赛西威**单车价值量为 1 比 25.7%。**威迈斯**单车价值量为 4,000 元, 占比 18%。此外, 科博达、和胜股份、香山股份宝武钢业和兴业科技等公司也与理想汽车有不同形式的合作。

机会前瞻

理想汽车 MEGA 车型热销, 开启盲定 1 小时 42 分钟预定量破万

2023 年 11 月 17 日, 盘后消息, 广州车展上理想汽车首款纯电车型 MEGA 正式发布, 并开启了盲定。在短短的 1 小时 42 分钟后, 预定量便突破了 10,000 台, 这款车型有望成为理想汽车的又一现象级产品。据机构预测, 2024 年 MEGA 平均月销量有望达到 5,000 至 6,000 辆。

理想 MEGA 是一款专为中国大家庭打造的 MPV 车型, 全球第一个搭载理想汽车与宁德时代联合研发的麒麟 5C 电池的量产车。该车型拥有充电 12 分钟即可续航 500 公里的强大功能, 为用户提供了极致的充电体验

理想汽车官方已公布 MEGA 的上市计划, 预计将在 2023 年 12 月正式上市, 2024 年 1 月展车进店正式交付用户

此外些相关公司也值得关注。**博俊科技、上声电子、德赛西威、威迈斯**等公司为理想 MEGA 的生产和供应提供了支持。其中, 博俊科技单车价值量为 1,500 元, 预计 2024 年理想汽车在其业务中将占比 37.5%。声电子单车价值量为 1,000 元, 占比 17.3%。**德赛西威**单车价值量为 1 比 25.7%。**威迈斯**单车价值量为 4,000 元, 占比 18%。此外, 科博达、和胜股份、香山股份宝武钢业和兴业科技等公司也与理想汽车有不同形式的合作。

三、大涨分析

天承科技:先进封装电镀液行业领先三呈和海力士计划扩大 HBM 产能, 其中 TSV 是 HBM3D 封装中最关键的工艺步骤, 成本占比接近 30%。公司在电镀液方面取得了突破, 是全球唯一实现此项技术突破的企业。在先进封装领域, 公司的电镀铜技等环节, 已与国内大客户展开合作并陆续送样。此术涉及 RDL、TIV 填孔电镀和 Bumping 的外, 公司在封装载板方面也取得了进展。应用于中科院微电子所等单位, 为封装载板的国产化需求提供了支持。总体而言, 三呈和海为十在 HBM 和先进封装领域具备技术优势和合作经验, 并在封装载板方面取得应用成果, 展示了公司在这些领域的实力和前景。

四、个股挖掘

O 驱动: 2023 年 11 月 17 个盘后网传纪要表示, 公司正在参与格思航天融资, 计划参 G60 星座卫星平台制造环节, 还期市场空间约 1300 亿。o 通信终端:公司希望通过本次合作寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务风会。参考《单个设备成本 3000 美元, 估算国内市场约 100 亿美元, 全球市场约 Starlink 达大额订季度公司合同负债 3.58 亿, 同比增长 1800%, 传军方保障车区向下到主要份额。

银河电子:计划拓展卫星通信市场

龙在中科:16 核 3C6000 近期交付添片

2023 年 11 月 19 日晚,公司公告了 15 日至 17 日的调研纪要。其中提到, 公司的服务器产品 16 核 3C6000 已经基本完成设计, 并将在近期交付流片。

在算力芯片方面,目前国内有三大主流派别,包括海外 NVOIA 引入派、华为昇腾派以及底层 P 设计的 ZZKK 派, 即龙芯中科。公司在这方面实现了全面的自主可 C 指令系统、处理器 IP 核到操作系统。包括

此外, 公司在 GPU 方面也有新的进展。公司自研图形处理器核 LG200 支持图形加速、AI 加速等功能, 并计划在正在研发的 2K3000 芯片中集成

公司还计划在 11 月 28 日召开发布会, 发布全新桌面级芯片处理器, 据说可以达到英特尔酷睿 10246001 代的水准。这将进一步增强公司在相关领域的竞争力, 同时也予着未来可能会有更多创新和突破。

中一科技:建设 8 万吨先进电子材料基地

公司于 2023 年 11 月 19 日晚公告, 计划出资 3.25 与合作伙伴共同设立控股子公司, 建设一个年产 8 万吨先进电子材料的产业基地。该项目主要涉及高性能电子铜箔和电池集流体的生产, 总投资约为 60 亿元。该项目建设将分为三期进行, 分别建设 3 万吨/年、3 万吨/年和 2 万吨/年的产能。每期建设至正式投产的周期约为 18 个月。公司表示, 武汉的全资子公司中一新材料已经涉足复合集流体相关业务, 将根据市场需求决定是否投入复合铜箔等产品的生产。目前, 公司的相关产品已经向客户送样。

45um 极浦钾电铜箔的核心技术, 并逐渐提高了双面光 6Hm 极薄理电铜筑在销此外, 公司还掌握了生产售中的占比。这些先进技术的掌握为公司在高性能电子材料领域的发展提供了有力的支撑。

力源信息:青款车型级 C 产品通过测试

近日, 子公司成功通过了 AEC-Q100 车规测试, 这是公司首款车规级 MCU 产品的重要标测试是判断芯片产品是否具备车用资格的关键指标之一。此次产品的突破不仅代表着公司志领域的研发实力再上新台阶, 同时也为公司从代理分销业务向芯片设计与代理分销业务的战略转在 MCU 型奠定重要基础。

而国内国产化率还不足 5%。预计到 2026 目前全球车用 MCU 市场中, 国际大厂占据超过 95% 的份额, 年, 中国 HCU 市场规模将达到 513 亿元。在这个领域, 公司自研的 MCO 产品已经量产了 9 个系列 26 个型号。此次推出的车规级 WCU 产品是公司从代理分销转型为芯片设计与代理分销的重要一步, 具有里程碑意义。

在 GMC 领域, 随着 HBM 技术的不断发展和堆叠层数的提升, 热需求也相应升级。这对 GMC 以及粉体颗粒的性能提出了更高的要求。公司的 F 材料产品包括液体封装材料 LMC 及 GMC 颗粒封装料。其中, 液体封装材料 LMC 已经量产并形成少量销售。而 GMC 颗粒填充封装料尚处于研发送样阶段。这种材料主要用在 HBW 堆叠中, 并已经开始向长案供货同时也已经导入华为的盛和晶微。

航宇微:卫星大数据或将与华为

2023 年 11 月 17 日, 华(中国提中心 1 牵头) 与航(事长军) 进行了一场深合作座谈交流。双方围绕卫星大数据存储、分发、处理及人工智能技术领域展开了深入沟通与交流。

在座谈会上, 华为对航宇微在遥感卫星领域的成果表示了充分认可, 并认为双方可以在智慧城市建设生态环保等领域探索深化合作的机会。同时, 华为也表示将与航宇微就具体项目进行深入交流。

事宇航电子、人工智能技术、微纳卫星星座及卫星大数据、智能测绘技术研制与生产的公航宇微是其实际控制人珠海市国资委。此外, 航宇微自研的玉龙(AD)芯片可以实现这在行业 12tops 的算中具有显著优势

其他资讯

spaceX 公司的星舰在 2023 年 11 月 18 日进行了第二次道级测试入行虽然任务以爆炸结束, 但是热分离系统的技术得到了验证, 这是迈向成功的一大步。同时, 国内商业航天公司星际荣耀空间成功完成了自主研发的液氧甲烷可重复使用验证火箭双曲线二号的飞行试验任务, 标志着中国在可重复使用运载火箭技术上取得了突破。

这些技术突破可能会对降低发射成本、增加发射频率以及加速卫星星座的建设产生积极影响。随着科技的不断发展, 我们期待更多的创新和突破能推动商业航天事业的发展。